

## **Caneta\_Retrabalho\_S\_951\_NC**

### **FLUXO DE SOLDA NO-CLEAN**

*(Fluxo de Solda Baixos Sólidos, No-Clean)*

#### **Informações Gerais**

Fluxo orgânico livre de haletos projetado para solda convencional e SMT para placas de circuito. Baixo teor de sólidos (2.0%) e natureza do ativador resulta em sistemas com praticamente nenhum resíduo deixado na montagem após a solda. As placas saem limpas após a soldagem. Não há nenhum resíduo para interferir com o teste elétrico, e a limpeza é eliminada.

Apresenta melhor desempenho de soldagem para minimizar curto e defeito de solda excessiva. Fluxo não-corrosivo e não-condutivo satisfaz exigências mais rígidas da especificação Bellcore TR-NWT-000078. Fluxo é satisfatório para a indústria automotiva, PCs, telecomunicações e outras aplicações onde considerações de confiabilidade sejam críticas. A resistência de isolamento superficial em placas soldadas é mais alto que a obtida por fluxos orgânicos hidrossolúveis típicos.

A Fórmula contém inibidor de corrosão tal que nenhum resultado de corrosão é formado quando são expostas superfícies de cobre nuas em ambientes úmidos. Esta característica permite que a fórmula passe confiança em testes de laboratório em superfícies nuas de cobre. A fórmula é classificada como Tipo ORL0 sob o padrão IPC ANSI/J-STD-004 da Indústria. Um saponífero como #5768 Bio Kleen pode ser necessário na água de lavagem se a limpeza é solicitada por acordo contratual.

#### **Aplicação**

O fluxo pode ser aplicado através de equipamento de fluxagem por espuma. O fluxo proverá uma frente de bolhas uniformes e estáveis. Após o fluxo, uma lâmina de ar deverá ser usada para remover o excesso de fluxo. A temperatura de pré-aquecimento para muitas montagens em placas de circuito é de 200-230°F (93-110°C) medida na face de componente da placa. A combinação do projeto da placa, duração de contato com da solda, forma de onda de soldagem ou tempo de pré-aquecimento podem afetar a temperatura de pré-aquecimento e os parâmetros desejados para uma melhor soldagem. O fluxo também pode ser aplicado por spray ou fluxagem por onda.

#### **Características**

- ◆ Reduz as despesas de limpeza
- ◆ Melhora o aspecto de soldagem
- ◆ Não-corrosivo e livre de haletos
- ◆ Não apresenta degradação da resistência de isolamento superficial
- ◆ Frente de onda de espuma uniforme e estável no equipamento de fluxagem
- ◆ Conforme a especificação Bellcore TR-NWT-000078 (emissão 3/12/1991)

#### **Controle de Processo**

O controle da fluxagem durante o uso é necessário para assegurar uma quantidade consistente de fluxo a ser aplicado nas placas. Uma menor quantia de resíduos remanescentes após a soldagem, reduz interferência no teste elétrico e os resultados de solda mais consistentes. A natureza complexa do sistema solvente para o fluxo faz com que seja necessária a utilização de Thinner #110, seja usado para repor as perdas evaporativas.

Os resíduos das placas de circuito e linhas de ar podem acumular-se no tanque de fluxo durante o uso. Quando excessivo isto se deposita em placas de circuito que podem formar acúmulo de resíduo em agulhas do teste in circuit (ICT). É necessário substituir o tanque de fluxo com fluxo novo quando resíduos em excesso acumularem-se no tanque de fluxo.

Inspeção da solda nas placas de circuito e componentes é aconselhada como parte do controle de processo para manter resultados de solda consistentes.

## Propriedades

### Físicas

	<b>#TS CR Tin/Lead NC</b>	<b>#110</b>
Gravidade Específica @ 75°F (24°C)	0.814 ± 0.003	0.805 ± 0.003
Perc. de sólidos, %(teste 2.3.34 como IPC-TM-650)	2.0	---
pH (5% solução)	3.4	---
Número Ácido, mgKOH/gm	14.3 ± 0.7	---
Conteúdo de Haletos	nenhum	---
Teste – Corrosão Copper Mirror	aprovado	---
Teste de Corrosão 2.6.15 como IPC-TM-650	aprovado	---
Resistência de Isolação Superficial* @85°C (185°F), 85% umidade como IPC-TM-650, Método 2.6.3.3	5 x 10 <sup>9</sup> ohms	---
Flash Point (T.O.C.)	16°C (60°F)	16°C (60°F)
Temperatura de Auto-ignição	399°C (750°F)	399°C (750°F)
Thinner	#110	---

\*SIR do controle não soldado = 5 x 10<sup>9</sup> ohm

### \* Resistência de Isolação na Superfície (SIR)

Atingirá o requerido no padrão Bellcore TR-NWT-000078 para a resistência de isolação superficial para placas de telecomunicações. Uma resistência de isolação maior do que 1 x 10<sup>5</sup> megohm (10<sup>11</sup> ohm) pode ser obtida sem limpeza.

Ambiente	35°C, 90% UR
Voltagem polarizada	45 - 50 volts DC
Placa Padrão	25-mil linhas, 50-mil espaços,

#### RESISTENCIA DE ISOLAÇÃO (11 dias)

	<b>TS CR Tin/Lead NC</b>
Padrão superior (não limpa)	5 x 10 <sup>5</sup> megohm
Padrão inferior (não limpa)	1 x 10 <sup>6</sup>
Controle sem solda (IR <sub>A</sub> )	4 x 10 <sup>7</sup>
IR <sub>MEDIA</sub>	1 x 10 <sup>6</sup>

{Necessidade: IR<sub>MEDIA</sub> = (10<sup>5</sup> x IR<sub>A</sub>) ÷ (10<sup>5</sup> x IR<sub>A</sub>)}

### Saúde e Segurança

Este produto, durante manuseio ou uso, pode ser prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. Leia a Folha de Dados de Segurança do Produto (MSDS) e rótulos de alerta antes de utilizar este produto.